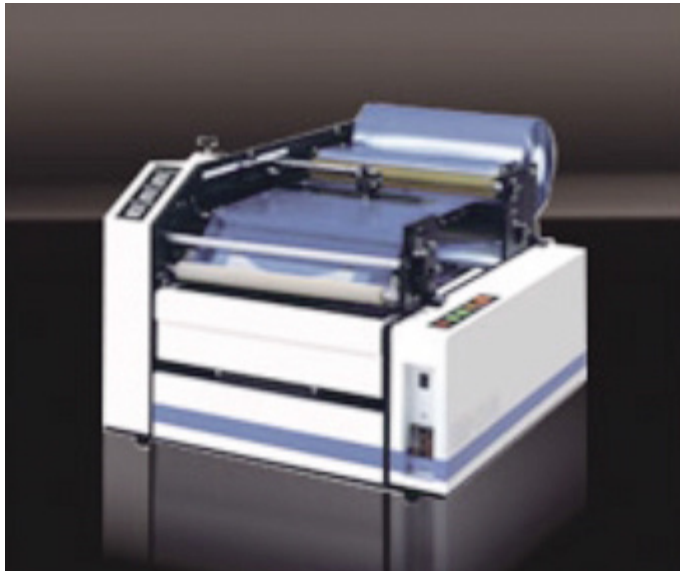


300mm半自动晶圆贴合机

RAD-2500m/12



规格

额定电源	供电电压	: AC100V±10%
	频率	: 50/60Hz
气源	位相	: 单相
	功耗	: 0.2kW
	供气压力	: 0.5-0.8MPa
	耗气量	: >150L/分钟(ANR)

适用的晶圆尺寸

300mm
也有可选用的晶圆尺寸、形状, 敬请垂询。

尺寸

机台宽度(W): 671mm
设备纵深(D): 950mm
(贴膜台拉出时 MAX. 1,380mm)
设备高度(H): 527mm

重量

110kg

UPH

22秒/片 (安装时间除外)

概述

半自动型晶圆贴合机用于操作员安装晶圆与晶圆环, 并粘贴预切割切割胶带。

- 选配功能**
- 静电消除器
 - 顶部护罩
 - 晶圆定位销

- 适用的胶带**
- 预切割切割胶带 “Adwill D系列”、“Adwill G系列”
 - 粘晶切割胶带 “Adwill LE胶带”

设备外形图

